



株式会社フェローテックホールディングス
中期経営計画進捗報告
(22/3期～24/3期)

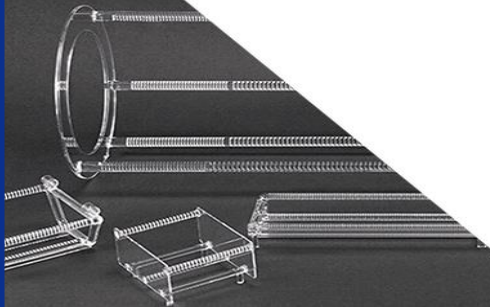
2021.12.21(火)



Ferrotec
Ferrotec Holdings Corporation



22/3期2Qの振り返り



業績

旺盛な需要により好調な推移、過去最高値を達成

好調な業績に伴い、2度の上方修正を実施（増配を含む）

売上高は前年同期比+43.8%、営業利益は同+174.3%となり、いずれも創業来過去最高値を記録

製品別

注力製品はいずれも好調

注力製品である半導体マテリアル、装置部品洗浄は好調

EVやグリーンエネルギー市場の発展により、パワー半導体基板の需要も急騰

安定事業であったサーモジュールにも新たな需要が続出

設備投資

旺盛な市場需要に伴い、積極的な投資を展開

新型コロナウイルスの影響で停滞していた企業の設備投資も回復の兆しを見せ、需要は旺盛
中期経営計画の投資方針に則り、注力製品群へ積極投資

資本調達

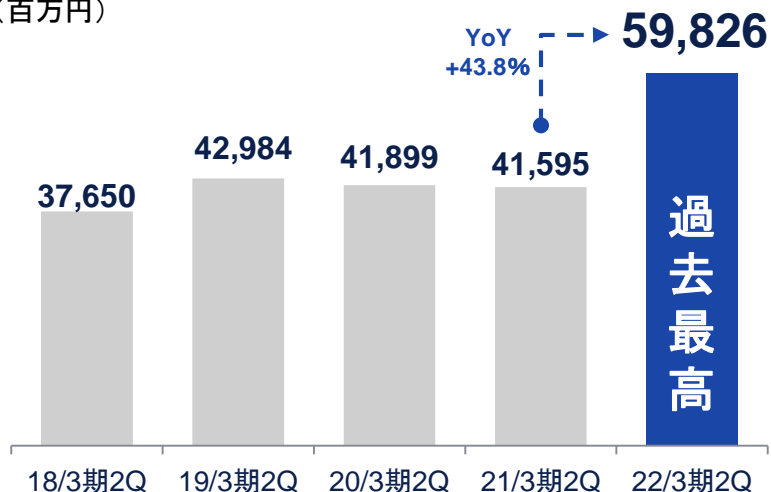
財務体質は改善傾向、中国資本の活用も進む

子会社の持分法適用会社化、中国資本との共同出資等で投資負担を分散
子会社の上場を視野に、中国での資本調達計画も展開

- 半導体マテリアル製品、部品洗浄、サーモモジュールなどの好調により、売上高は過去最高に
- 好調な半導体市況、およびシリコンウエーハ子会社の非連結化で、営業利益も急回復

売上高

(百万円)



営業利益

(百万円)



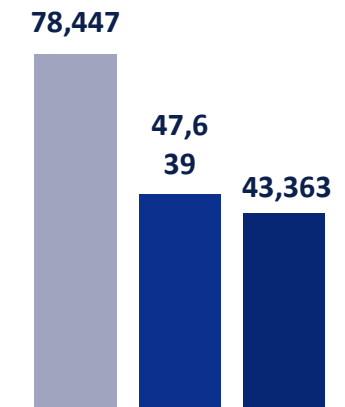
- ウエーハ事業の非連結化(21/3期の下期に実施)により、主要経営指標は大幅な改善傾向

主要指標の推移

(金額は全て百万円)

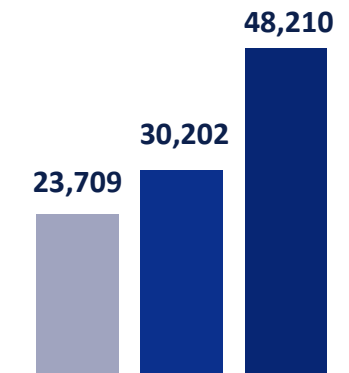
有利子負債

■ 20/3期 ■ 21/3期 ■ 22/3期2Q



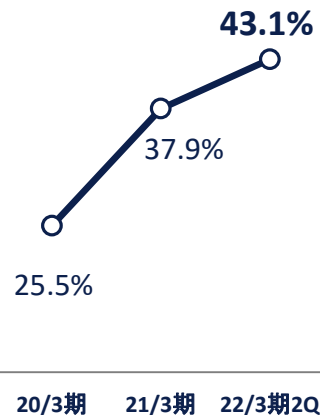
現金及び同等物

■ 20/3期 ■ 21/3期 ■ 22/3期2Q



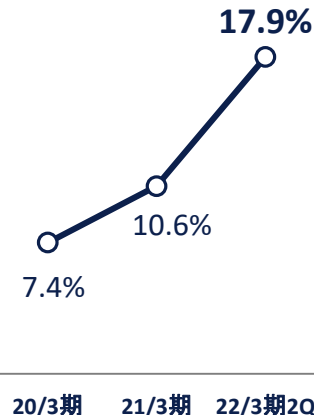
自己資本比率

※24/3期(中計)目標
40%超



営業利益率

※24/3期(中計)目標
16.7%



- 旺盛な需要を踏まえ、8/13の上方修正に続き、11/12に更なる上方修正を発表
- 中期経営計画で策定した23/3期予想を1年前倒しで達成および超過の見通し

	22/3期(予)		23/3期 (中計)	24/3期 (中計)
	8/13修正予想	現予想 (11/12修正)		
売上高	1,150 億円	1,250 億円	1,250 億円	1,500億円
営業利益	200億円	225 億円	190 億円	250億円
営業利益率	17.4 %	18.0 %	15.2 %	16.7%
親会社に帰属する 当期純利益	200億円	235 億円	110 億円	150億円

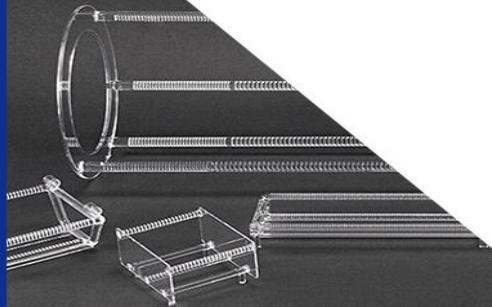
1年前倒しで
目標達成へ



Ferrotec
Ferrotec Holdings Corporation



注力製品の状況、下期の見通しについて



半導体製造装置向け冶具・消耗材(当社主力のマテリアル製品群)



石英



シリコンパーツ



セラミックス



CVD-SiC

当社製品群の強み: 設備投資連動型(真空シール)のみでなく、**半導体デバイスメーカーの生産稼働連動型リピート消耗材(マテリアル製品)**、サービス(洗浄・再生ウエーハ)をラインアップ



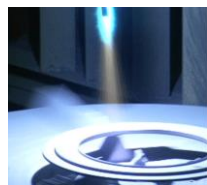
真空シール

※半導体・FPD
製造装置部品
(市場占有率:65%(TOP))



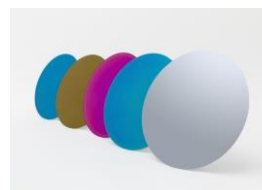
金属精密加工

※今後の中国国内顧客
(工場)増で伸長の見通し



装置部品洗浄

※中国市場に特化
(中国市場占有率:60%(TOP))



再生ウエーハ

※中国市場に特化
(22/3期~新規事業)

持分法適用関連会社での事業



シリコンウエーハ

※月産能力6インチ 42万枚、8インチ 45万枚
12インチ3万枚(今後→10万枚→20万枚へ)



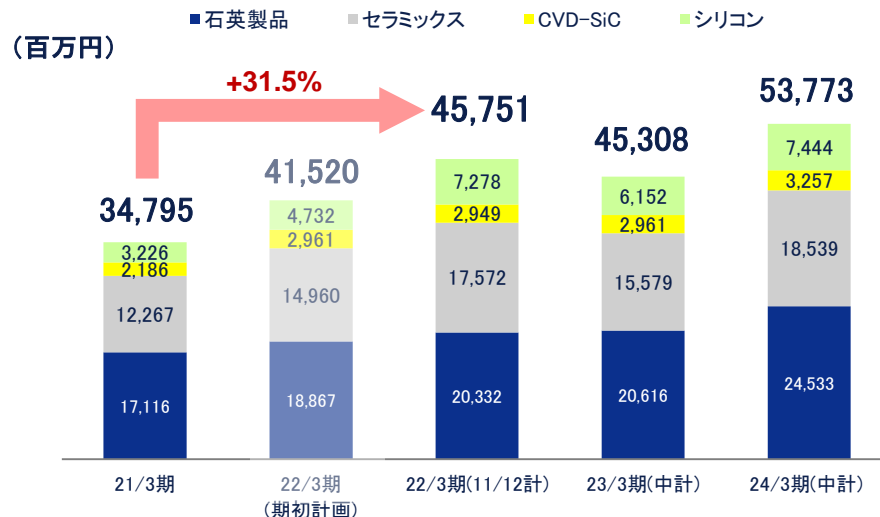
SiCウエーハ

※開発~量産化
(22/3期~新規事業)

*対象製品は石英、セラミックス、CVD-SiC、シリコンの4製品



通期売上高推移



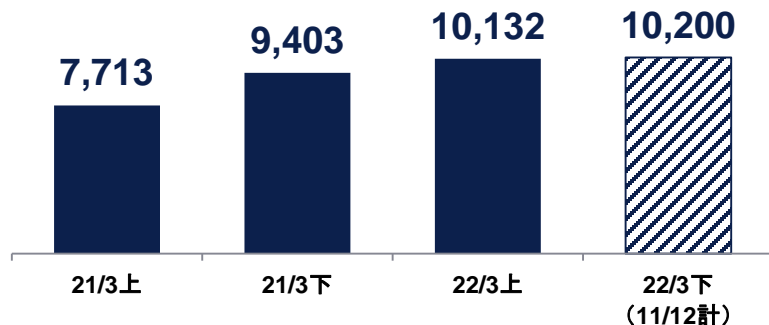
3年間(24/3期)の増収目標 54.5%

- 22/3期(11/12計)は年初計画比:10.2%増(前期比31.5%増)の見通し
- 半導体市場は、5G関連やテレワークによるデータセンターの需要拡大等、堅調に推移の見通し
- 半導体材料製品については消耗品需要が多いため、半導体メーカーの生産稼働率に連動する割合が高い(一部投資連動型もあり)
- 半導体前工程製造装置(WFE)市場は前年比プラス成長の見通しが続いており、材料製品も随時生産能力増強で需要増に対応中

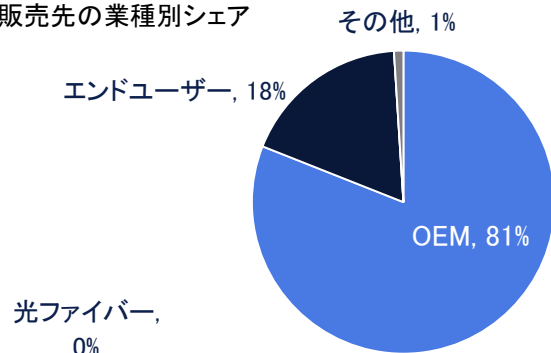


半期売上高の推移

(百万円)



販売先の業種別シェア



3年間(24/3期)の増収目標: 43.3%

- 22/3期(11/12計)は年初計画比: **7.8%増**(前期比**25.9%増**)の見通し
- 半導体製造装置メーカーおよびデバイスメーカーの高水準の新規投資に加え、消耗品需要の底堅さが顕著
- 半導体製造装置市場が21年~22年もプラス成長の見通し
- 中国の浙江省杭州・常山、江蘇省東台、日本の山形市に工場を配置し、増産を継続中



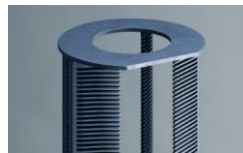
熟練技能者による
石英の火加工



増産を進めていく
石英の機械加工

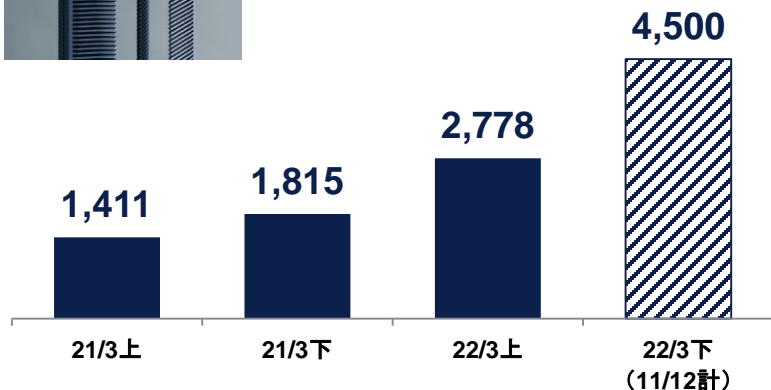
日本、中国における石英製品工場拠点マップ



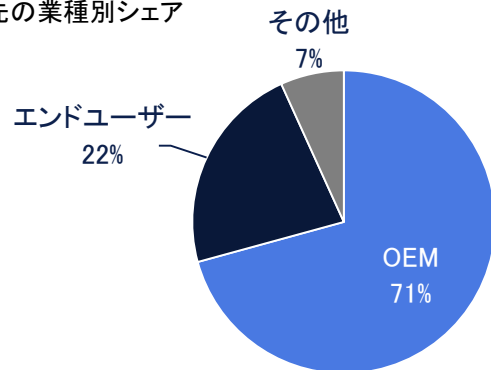


半期売上高の推移

(百万円)



販売先の業種別シェア



3年間(24/3期)の増収目標: 130.8%

- 22/3期(11/12計)は年初計画比: **53.8%増** (前期比**125.6%増**) の見通し
- 半導体プロセスの微細化が進むなか、シリコンウエーハと熱膨張係数が同一で高純度なシリコン製部材への切替え需要が拡大中
- このため、半導体製造装置メーカー、デバイスメーカー向けの顧客需要に対応し、同製品製造子会社(銀川)において、第三者割当増資を実施し、大幅な生産能力増強を実施中
- 中国の寧夏省銀川、および浙江省杭州に工場を配置
- **シリコンパーツ、および石英坩堝を製造する銀川製造子会社で中国市場での上場を準備中**

インジェクター



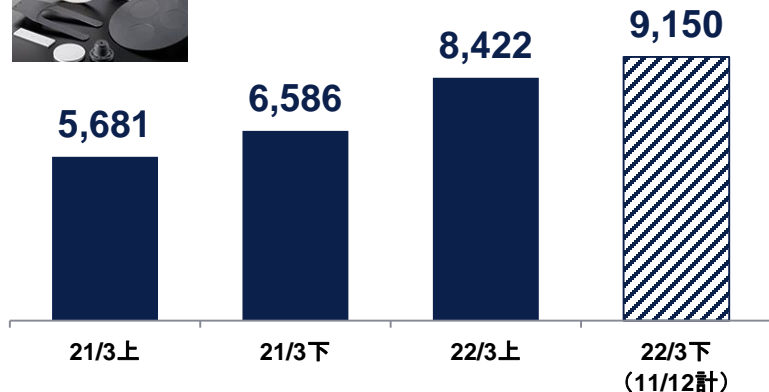
フォーカスリング



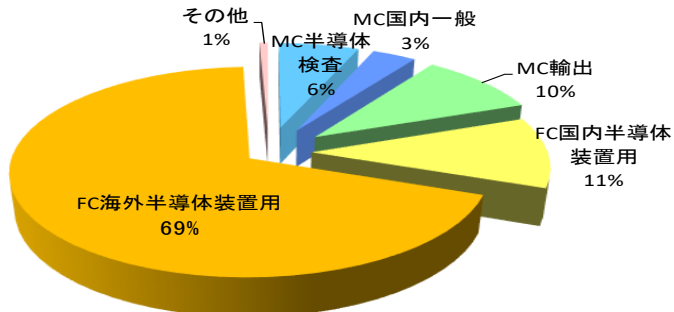


半期売上高の推移

(百万円)



セラミックス製品の製品別販売シェア



注) FC: ファイン・セラミックス
MC: マシナブル・セラミックス(ホトパール)

3年間(24/3期)の増収目標: 51.1%

- 22/3期通期(11/12計)は年初計画比: 17.3%増(前年比43.2%増)の見通し
- 22年10月竣工を目標に石川第二工場を建設中。国内FC/MC増産体制強化
ファインセラミックス(FC) (売上全体の約80%)
- 国内海外とも半導体製造装置部品の販売が大変好調。この為、中国浙江省杭州工場では、生産能力増強に対応中
マシナブルセラミックス(MC) (売上全体の約20%)
- 国内海外半導体検査治具用セラミックス部品の販売が大幅に増加。今後はレーザー加工(高付加価値)品の販売を更に強化。

兵庫
ファインセラミックス開発・量産



中国杭州
ファインセラミックス量産

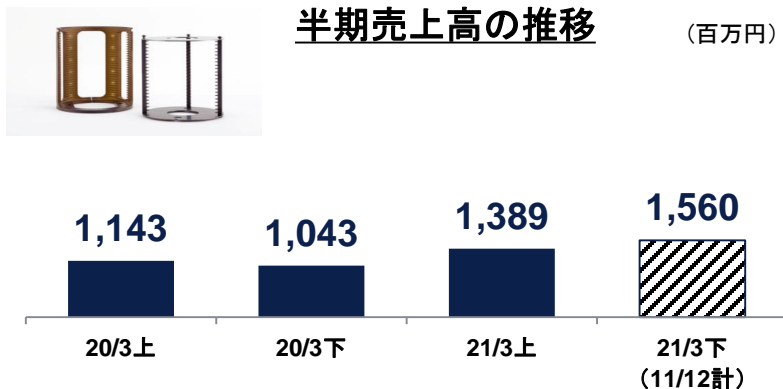


石川
マシナブルセラミックス量産

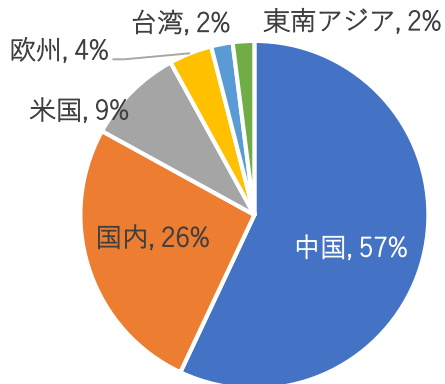


石川
ファイン・マシナブルセラミックス開発





地域別販売シェア



3年間(24/3期)の増収目標: 49.0%

- 22/3期通期(11/12計)は年初計画比: 0.4%減(前期比34.9%増)の見通し
- CVD-SiCは、日本における「材料、加工、コーティング技術」の開発優位性が強み(岡山工場で開発、量産を担う)
- 日米半導体製造装置向けの需要増対応、および新規採用に注力中(熱処理炉、エッチャーパーツなど)
- 中国顧客の中期的な成長に連動した、生産能力整備も重点課題



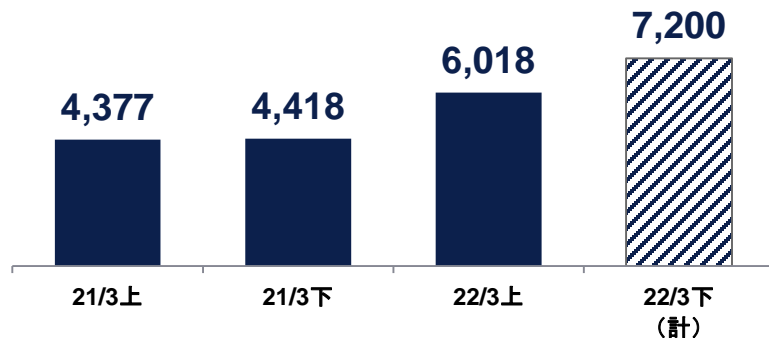
岡山: CVD-SiC
開発・量産



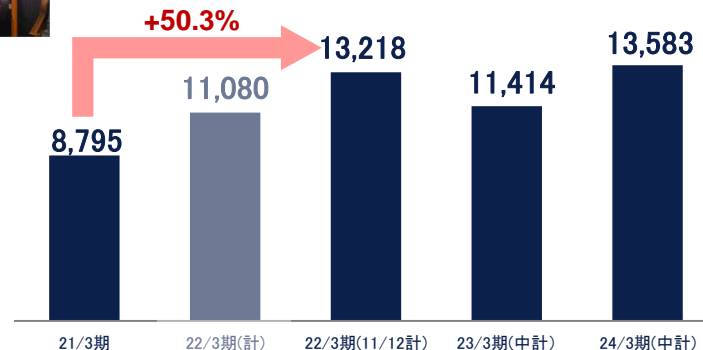


半期売上高の推移

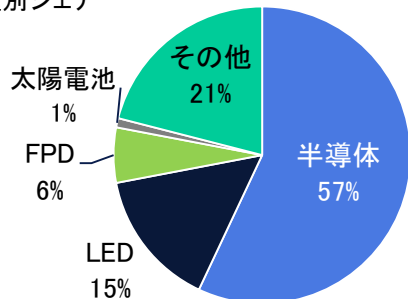
(百万円)



21/3期～24/3期 通期売上高推移



販売先業種別シェア



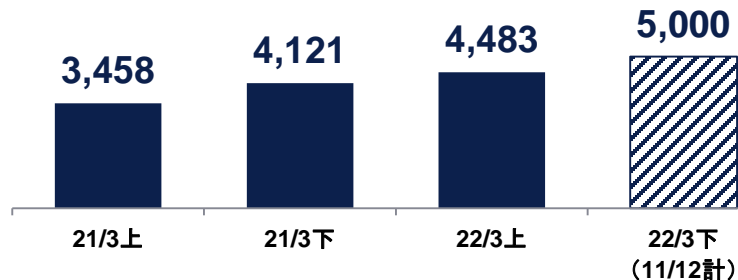
3年間(24/3期)の増収目標: 54.4%

- 22/3期(11/12計)は年初計画比:19.3%増(前期比50.3%増)の見通し
- 真空シールは、半導体製造装置向け新規投資の需要が堅調に推移
- また、中国市場などを中心に、金属加工受託ビジネスも伸長(真空チャンバー、ロボットパーツ他)
- 中国では杭州、常山に量産拠点を構えるが、今後、金属加工受託ビジネスの拡大が想定されるため、常山での生産能力増強を実行予定

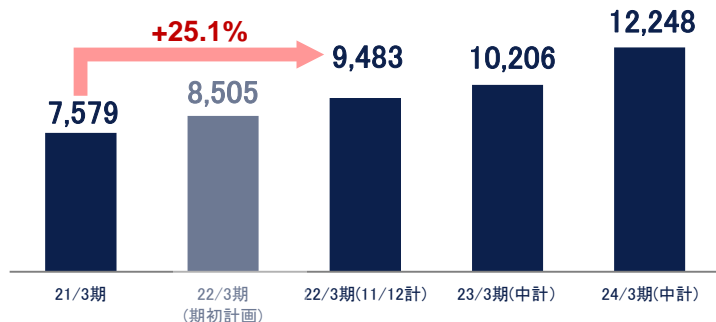


半期売上高の推移

(百万円)



通期売上高推移



3年間(24/3期)の増収目標: 61.6%

- 22/3期(11/12計)は年初計画比: **11.5%増** (前期比**25.1%増**) の見通し
- 中国国内に特化した事業であり、半導体、および FPD(有機EL、液晶)顧客の生産拡大に連動して毎年順調に事業規模を拡大中
- 半導体マテリアル製品と同様に、顧客の生産稼働に連動する「ストック型」事業の為、安定した売上げの確保がし易い(今後も事業拡大が堅調に続く見通し)
- 5拠点7工場(22年からは6拠点9工場)を整備し、増産対応を継続している事から、中国国内での当社シェアは60%に迫る

部品洗浄：安徽省銅陵を中心に、事業拡大の方針

- 安徽省銅陵の子会社を中国市場で上場させるための準備中(21年6月深圳創業板申請済み)
- 中国半導体、FPD顧客向けに生産能力の増強を継続中(銅陵・内江・広州にて随時増強)

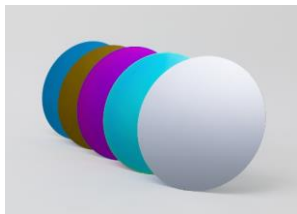
★部品洗浄ビジネスは、安徽省の銅陵を中心とする組織再編を実施済み

★顧客の近くできめ細かいサービスを展開(5拠点7工場 → 22年以降6拠点9工場体制へ)



※新たに、広州富樂徳科技發展有限公司(新設)が傘下に





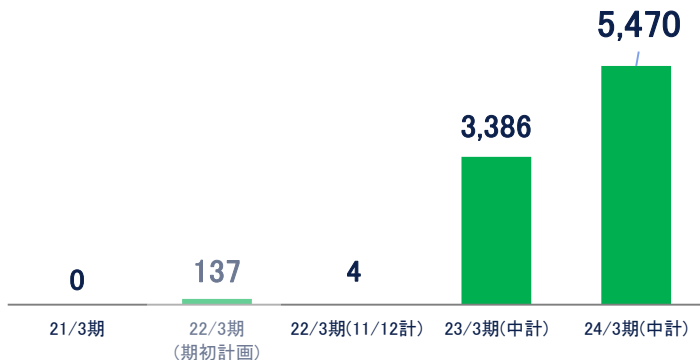
安徽省銅陵市内に建設した再生ウエーハ工場

3年間(24/3期)の増収目標：54億円

- ウエーハ事業のリソース、洗浄事業のノウハウを転用。被膜除去プロセスは、パートナーと技術提携・・・21年2Q(4-6月)試作開始、本格量産は22/3期 1Q(1-3月)以降の見通し
- 中国半導体国産化の加速により、ウエーハ再生需要が急増。12インチを中心に、旺盛な顧客需要に対応するため、第1期の月産能力を6.5→12万枚に増強(投資額：78.5→140.2億円)※最終的に20万枚を想定
- 第三者割当増資：21年3月 第1回目(20年12月)と合わせて計11.4億円(7.1億人民元)の増資を実施し、再生ウエーハ子会社の増資後の資本金は、189.9億円(12.1億人民元)へ

通期売上高推移

(百万円)

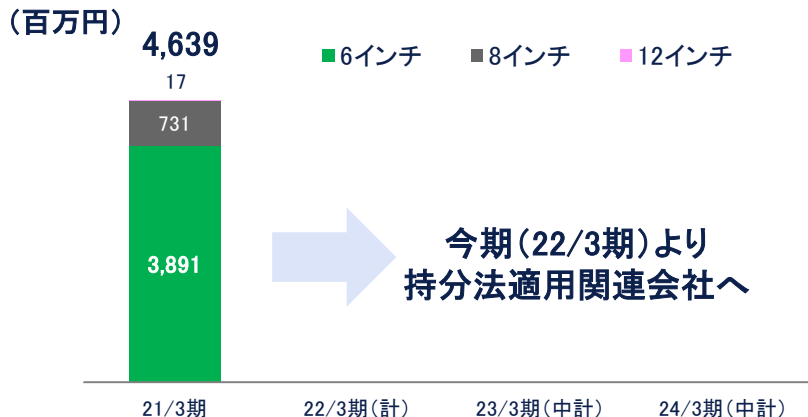




浙江省杭州市内のウエーハ加工工場

12インチを 月産20万枚体制へ

売上高推移



- 半導体ウエーハ子会社(CCMC)の株式譲渡、及び2度に渡る第三者割当増資により、当社グループの株式保有は**23%台へ低下**(21/3期4Qから持分法適用関連会社に異動)
- 6インチ**: 足元での需要は堅調に推移。**22年度以降、月産45万枚の生産能力に対し、更なる増強を検討中**
- 8インチ**: 自社での直販体制を強化中。上海・杭州にて21年度内に月産30万枚体制へ**(22年度中に月産45万枚体制を目指す)**
- 12インチ**: 月産3万枚体制から段階を踏み、10万枚→20万枚体制を構築予定(23年度以降の目標。設備投資資金は中国での第三者割当増資を活用)。
- 21年度末は、月産7万枚体制を目標に増産対応中

- 杭州ウエーハ工場の8インチ、12インチ新規顧客認定強化、および量産規模拡大中

シリコンウエーハ

寧夏銀和半導体科技有限公司 第一工場
寧夏銀和半導体科技有限公司 第二工場

上海ウエーハ工場

6'、8' インチ

上海申和熱磁電子有限公司
杭州中欣晶圓半導體股份有限公司

銀川インゴット工場

6'、8'、12' インチ

インゴット

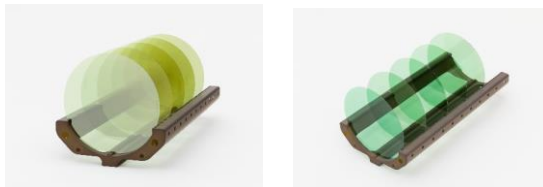
杭州ウエーハ工場(CCMC)

8'、12' インチ

半導体材料研究院設置
(21年10月28日CCMC内)

※浙江省麗水市に CCMC(32%出資)が政府系・民間系ファンドと合併でエピタキシャルウエーハ加工拠点を設立
(23年上期に量産開始:8インチ:100千枚/月、12インチ:200千枚/月)

SiC(炭化ケイ素)ウエーハ(非連結)



- ◆ 20年10月安徽省銅陵市に、中国科学院上海硅酸盐研究所(SICCAS)、政府・民間系ファンドとの合併会社を設立。中国での最先端半導体(◎第三世代半導体)として今後の市場成長が期待される、SiC(炭化ケイ素)単結晶のインゴット、ウエーハの開発、製造に取り組む。 ※21年10月29日竣工式実施

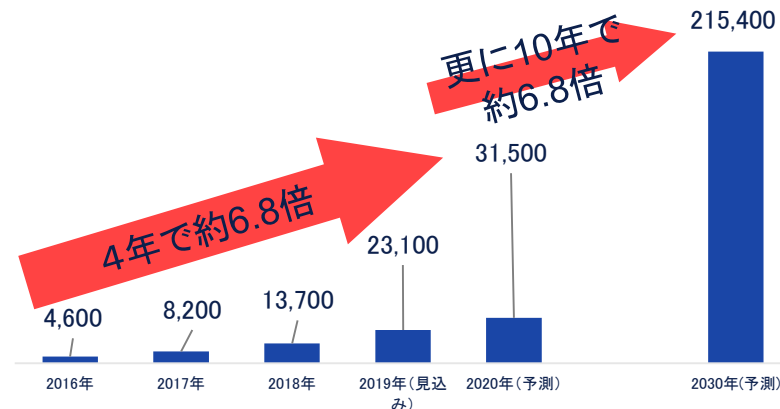


■ 合併会社で当該事業に取り組む背景①②③

- ① 当社グループ: 半導体Si単結晶事業で培った欠陥制御技術、装置製造技術。CVD-SiC(半導体製造装置向け治具)事業を通じたSiCに対する知見と顧客基盤を保有
- ② SICCAS: 中国トップクラスのSiC研究機関。知財、人材保有
- ③ 資金調達: 政府・民間系ファンド、および政府補助金サポート

<金額: 百万円>

SiCウエーハの市場規模予測



*グラフは富士経済の資料より当社作成

サーモモジュール



※自動車・半導体製造装置・通信・医療バイオ・民生品など、温度調整デバイスとして用途が拡大中
(市場占有率:36%(TOP))



PCR検査用途の増加
DNA増幅を活用し、顕微鏡では見ることのできない病原体の有無を検査する際に必要

パワー半導体用絶縁基板



※世界の消費電力削減のトレンドに対応し、パワー半導体顧客からの需要が拡大中(アルミナセラミックス基板に銅回路を接合する DIRECT COPPER BONDING技術)

パワー半導体のアプリケーション



磁性流体

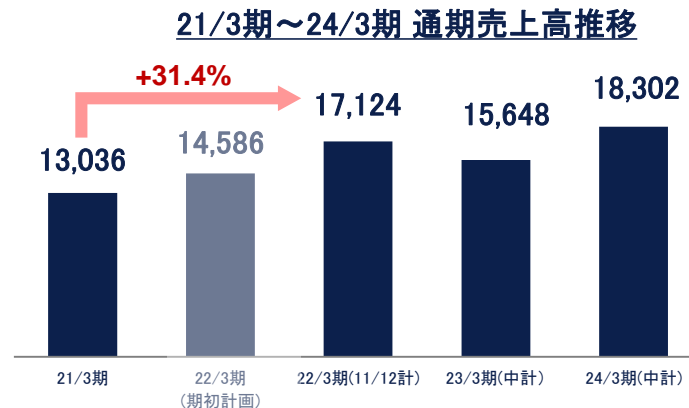
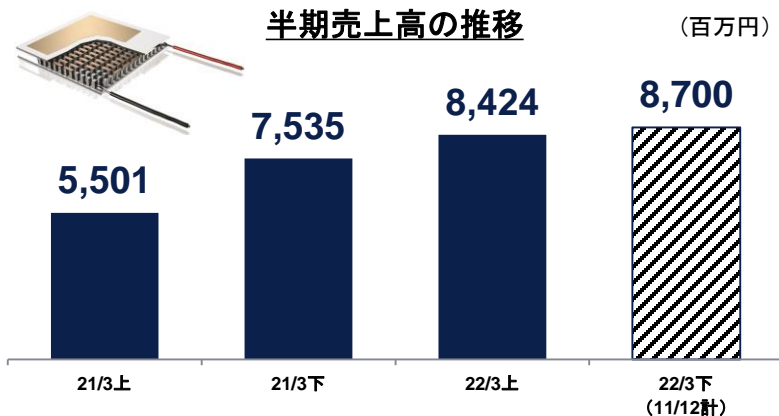


※自動車スピーカーや、高音質TVスピーカー、スマホのバイブレーション向けへの用途が拡大中
(市場占有率:80%(TOP))

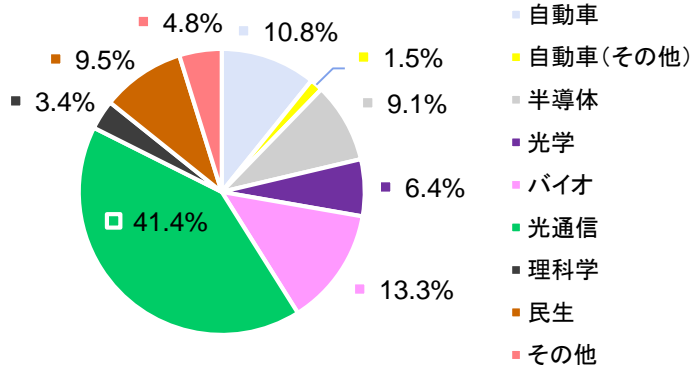


高音質ヘッドホンにも採用

※振動を安定化させ、迫力の重低音、臨場感を実現

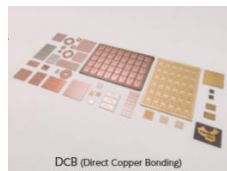


22/3期2Q サーモモジュールの用途別構成比率



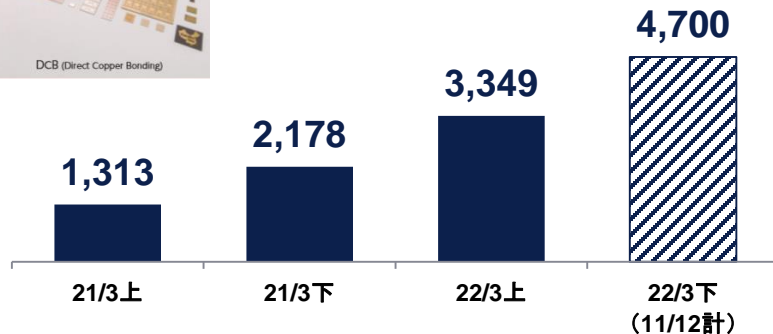
3年間(24/3期)の増収目標: 40.4%

- 22/3期(11/12計)は年初計画比:17.4%増(前期比31.4%増)の見通し
- 5G通信機器用途が引き続き好調、その他、PCRなどバイオ装置用途、半導体分野も伸長中
- 既存の自動車温調シート向けは減収基調。今後は、カップホルダーなどのエクステリア用途の他、自動運転等に使用されるカメラ向けやセンサー向けなど重要機能部品用途において、販売拡大を目指す

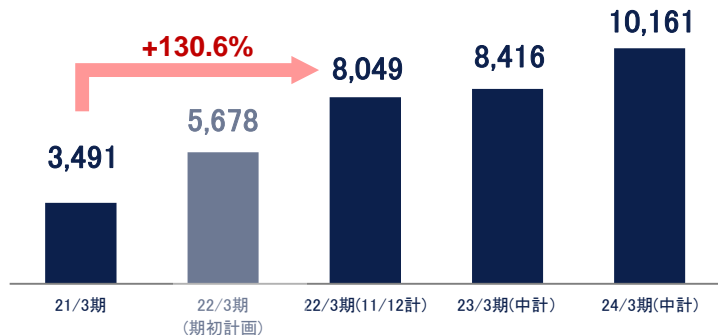


半期売上高の推移

(百万円)



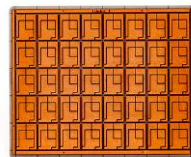
通期売上高推移



3年間(24/3期)の増収目標: 191.1%

- 22/3期(11/12計)は年初計画比**41.8%**増(前期比**130.6%**増)の見通し
- 江蘇省東台の子会社を中国市場で上場させるための準備中
- 東台にパワー半導体研究院を建設中(22年度以降稼働)
- 東台のパワー半導体基板工場は生産能力拡大中、来期以降も増収の見通し(月産能力(21年内):上海・東台工場 DCB基板 60万枚→100万枚、AMB基板 10→20万枚へ)
- 更に、高耐熱・高強度のDPC基板を投入し、光通信やパワーLED製品等への展開も強化の予定

★車載用途増により、AMB基板需要が増加、21年度DPC基板も投入



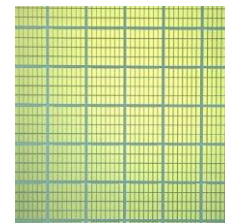
DCB基板
(Direct Copper Bonding)

材質: アルミナセラミックス



AMB基板
(Active Metal Brazing)

材質: 窒化ケイ素



DPC基板
(Direct Plated Copper)

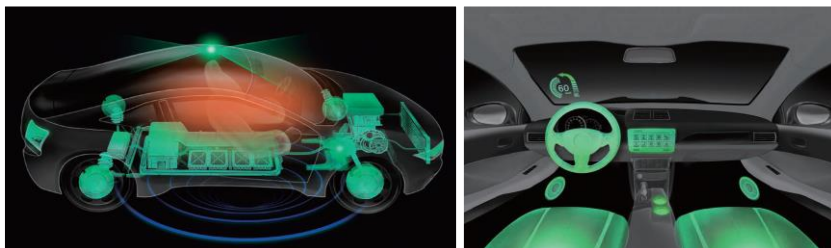
材質: アルミナセラミックス等
メタライズ(Ni等)

- 既存事業の高い技術力を活用し、EV、PHV、自動運転システム等、アプリケーションの大きな変化が見込まれる自動車市場への参入を今後本格化

当社のコア技術製品

サーモモジュール 磁性流体 パワー半導体基板

車載用途への活用を目指す



1 EV・自動運転技術の普及による需要増加期待

小型かつ軽量で温度調整が可能なサーモモジュールはEV・自動運転技術向けに活用が期待される

■ CMOSイメージセンサー



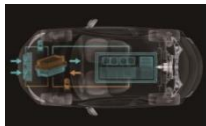
CMOSイメージセンサーは温度が上昇するとダークカレントノイズが発生

■ LiDAR



レーザー光の計測精度に温度環境は影響

■ 電池



バッテリーの寿命及びパフォーマンスに温度環境は影響

2 車載用温度センサで高いシェアを有する大泉製作所との資本業務提携

2021年3月に大泉製作所と資本業務提携を締結



OHIZUMI

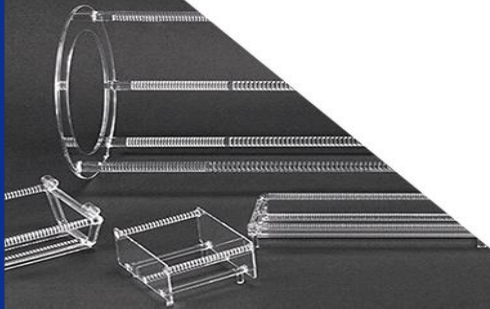
大泉製作所の車載・空調用の温度センサ技術と
当社のサーモモジュール技術を組み合わせ
新たな事業分野を創出



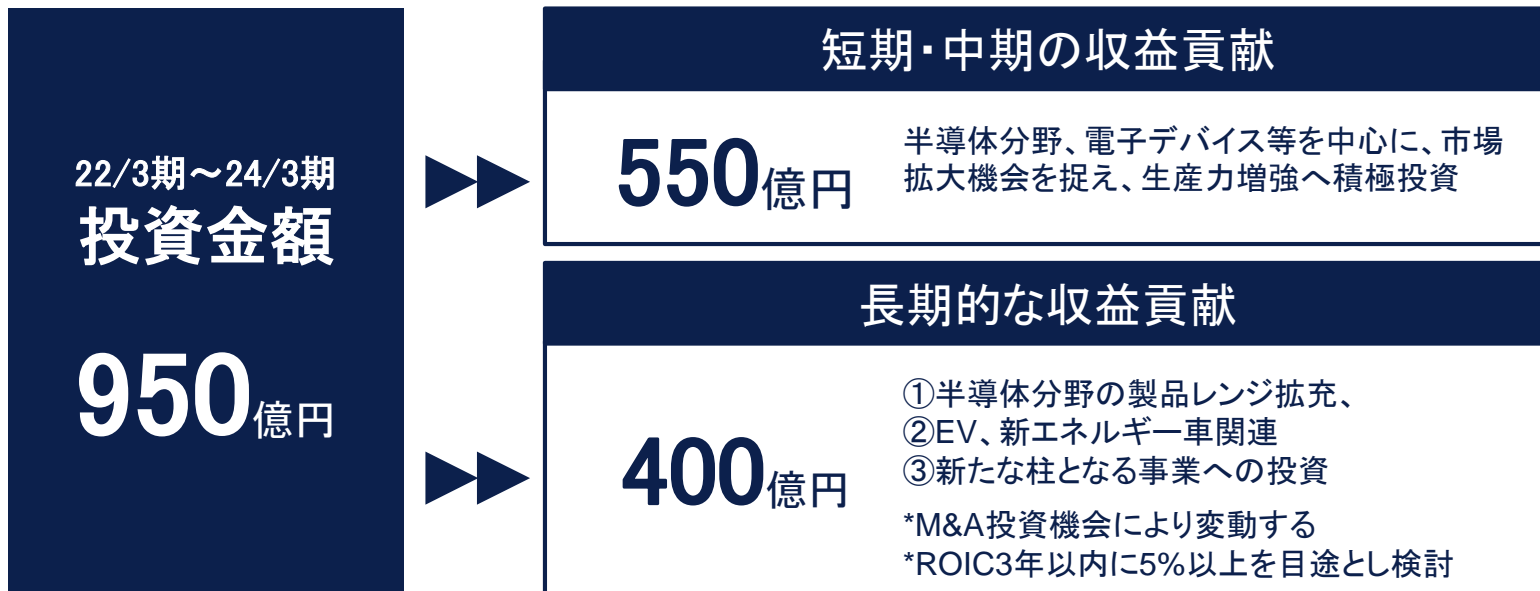
Ferrotec
Ferrotec Holdings Corporation



投資計画、資本政策について



- 投資金額は3年間で総額950億円を予定(中期経営計画より変更なし)
- 半導体分野、電子デバイス等の市場拡大機会を捉えた増産投資を実行すると共に、長期的な成長に向けた戦略投資を積極的に検討する



11/22発表の新株式発行及び売出しについて

- 11/22に新株式発行及び売出しを発表
- 中期経営計画において開示のとおり、成長投資を徹底的に追及

新株式発行及び売出しの詳細

本株式発行の目的	市場拡大機会を捉えるための積極的な増産投資の実行のため(中期経営計画のとおり)
発行形態	①公募による新株の発行、及び ②第三者割当てによる新株式発行(オーバーアロットメント(以下OA)による売出し)
募集売出し株式数	①新株式発行:4,858,300株、②OAによる売出し(上限:728,700株) 合計(①+②):5,587,000株*上限の場合
募集価格	1株につき3,667円 *12/1の終値をもとに決定済。割引率4.01%
手取概算額合計上限	193.1億円
資金使途	当社グループ子会社の生産能力増強への投資等へ充当(後述)
第三者割当先	野村證券株式会社
払込期日	①公募による新株式発行:2021年12月7日 ②第三者割当による新株発行:2021年12月28日
資金使途	当社グループ子会社の生産能力増強への投資等へ充当(後述)

• 手取概算額(12/1時点)193.1億円の使途

半導体等 装置関連	15億円	石英事業の生産能力増強	<江蘇富楽徳石英科技有限公司(FTJQ)> ▶ 「東台工場」における石英製品生産設備等への投資資金
	50億円	金属加工事業の生産能力増強	<浙江先導精密機械有限公司(FTAP)> ▶ 「常山工場」における金属加工設備等への投資資金
	30億円	セラミックス事業の特殊製品開発・ 量産のためのグリーンフィールド投資	<縹フェローテックマテリアルテクノロジーズ(FTMT)> ▶ 「石川第二工場(新設)」における特殊セラミックス製品の 生産設備等への投資資金
電子 デバイス	33億円	サーモモジュール事業の 生産能力増強	<浙江先導熱電科技股份有限公司(FTAT)> ▶ 「常山工場」におけるサーモモジュール及びコンシューマー 製品の各生産設備等への投資資金
その他	45億円	中国本部棟の建設	<上海漢虹精密機械有限公司(FTSM)> ▶ 中国本部における中国の統括機能及び研究開発機能強 化のための投資資金 ▶ ①ブランド力向上、②高度人材の採用、③R&Dの強化等
	20億円	借入金返済	▶ 社債の償還資金に充当

*手取概算額は一株当たり株価は2021年11月15日終値の4,400円に基づく

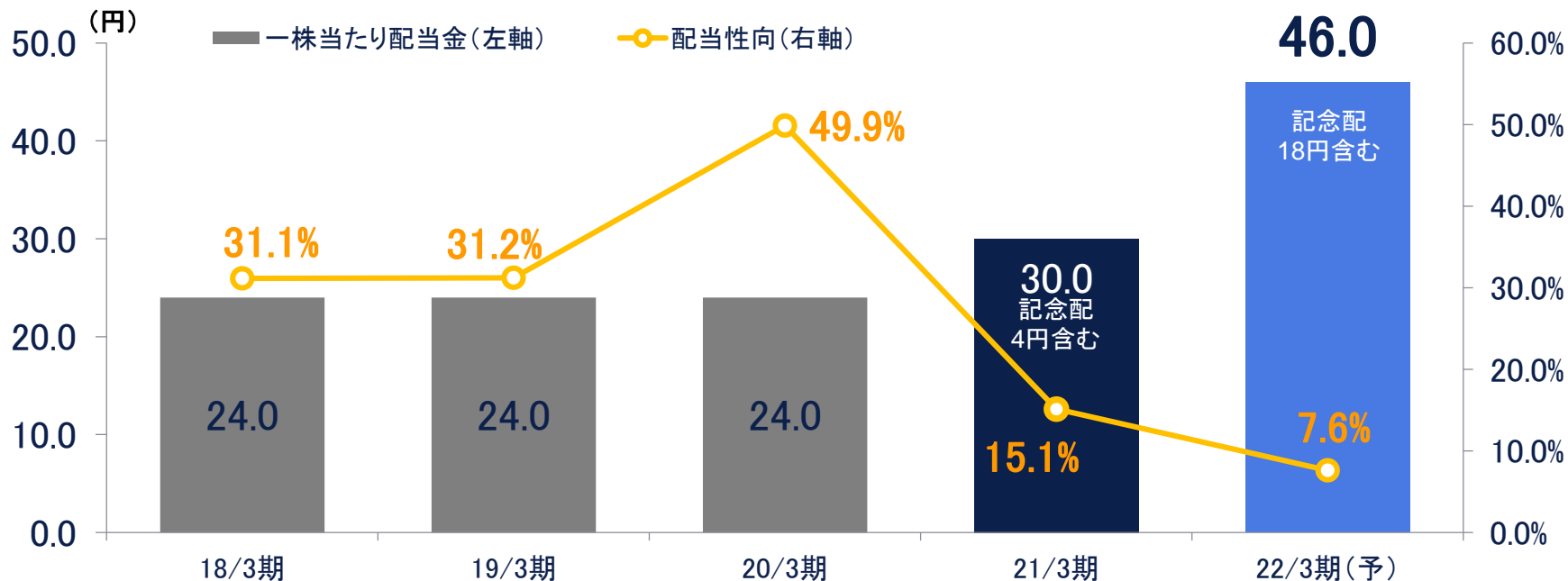
- 投資資金需要・事業ボラティリティ・財務負担等を勘案しながら、成長機会を捉えるための投資資金として、第三者割当等を実行

■ 主要な中国子会社における調達・出資比率の状況(~2Q末)

	当社中国子会社	開示日付	2Q末までの外部調達額	出資比率の変化(期初 ⇒ 2Q末)
持分法適用会社	 半導体シリコンウエーハ子会社 ■ 杭州中欣晶圓半導体股份有限公司	21/7/15	553億円	29.5% → 23.0%
	 SiC単結晶インゴット・ウエーハ子会社 ■ 安徽微芯半導体材料有限公司	20/10/16	32億円	38.98% → 29.5%
連結子会社	 石英坩堝・シリコンパーツ子会社 ■ 寧夏富樂徳石英材料有限公司	21/2/10 21/8/6	91億円	90.0% → 66.7%
	 パワー半導体基板製造子会社 ■ 江蘇富樂徳半導体科技有限公司	20/11/17 21/2/10 21/8/6	83億円	88.9% → 66.7%
	 精密部品・装置部品再生洗浄子会社 ■ 安徽富樂徳科技發展股份有限公司	20/8/14	-	67.7% → 67.5%
	 半導体再生ウエーハ子会社 ■ 安徽富樂徳長江半導体材料股份有限公司	20/10/16	44億円*	31.8% → 22.5%*

*半導体再生ウエーハは、グループ会社が現物出資後、出資比率は41.3%の予定(連結前提)

- 好調な業績に伴い、8/13に1株当たり配当金30円から46円への増配を発表
- 22/3期以降は投資拡大のため配当性向は下がるものの、収益性改善に応じた安定配当による最大限の株主還元を目指す

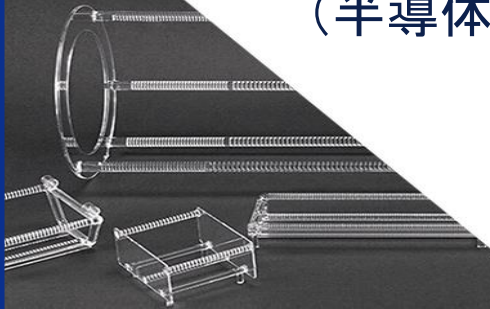




FerroTec
Ferrotec Holdings Corporation



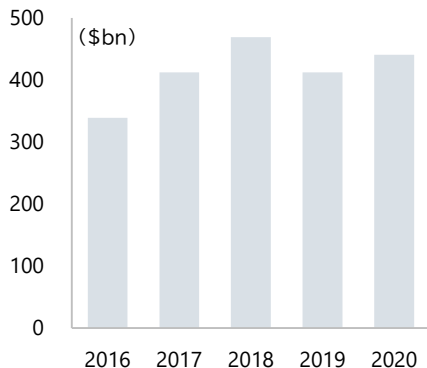
市場環境の認識 (半導体市場動向、中国の半導体国産化の加速)



- 高成長な半導体、半導体製造装置、半導体材料市場よりも高い成長を実現

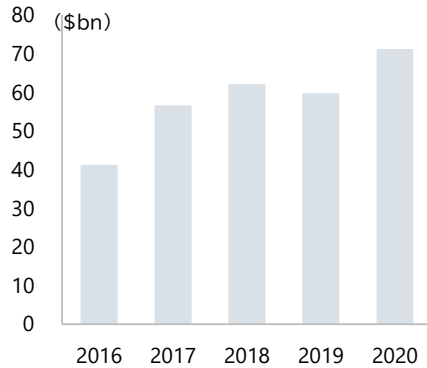


世界半導体出荷額



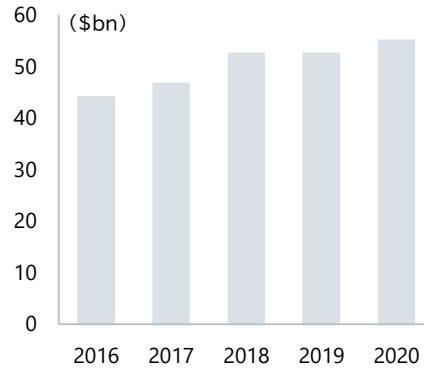
CAGR(CY16~CY20) **6.8%**

世界半導体製造装置販売額



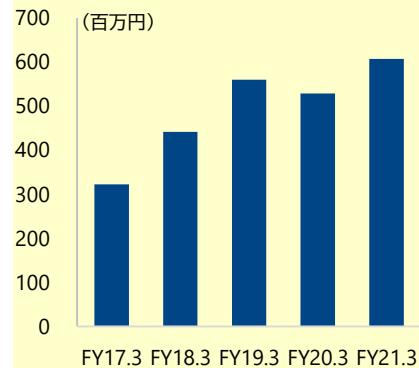
CAGR(CY16~CY20) **14.6%**

世界半導体材料販売額



CAGR(CY16~CY20) **5.7%**

フェローテックHD 半導体等装置関連事業



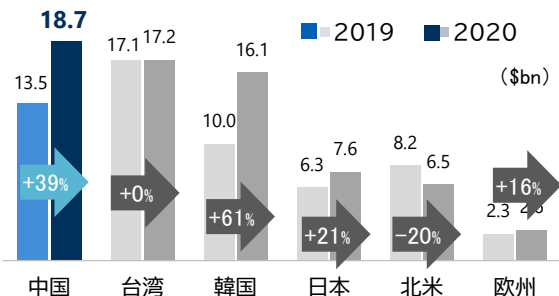
CAGR(FY16~FY20) **17.1%**

急伸する中国半導体市場での存在感を拡大

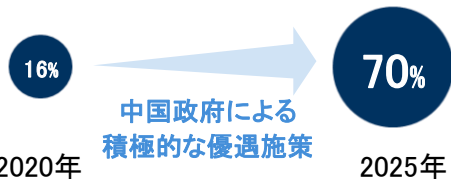
- 中国ローカル半導体企業の国産化の動きも追い風に、中国資金・知財・人材を活用することで、高い成長が見込まれる中国市場のメリットを最大限享受

中国市場の成長

世界の半導体製造装置販売額

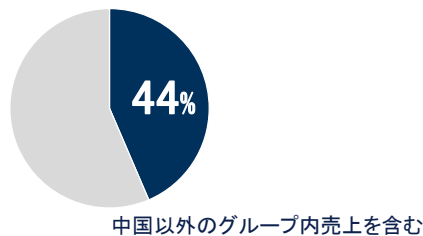


中国製造2025で掲げる半導体自給率

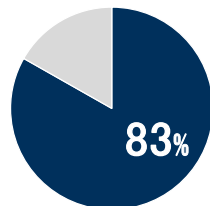


中国市場の成長

売上高に占める中国子会社比率



有形固定資産に占める中国比率



中国市場におけるフェローテックの戦略

中国半導体企業主要拠点付近に集中した工場建設



中国政府・外部資本の資金面・知財面でのサポートを通じた成長の加速

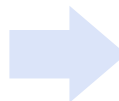


中国外部資本の資本導入
中国政府による補助金



中国研究機関との合弁設立を
通じた知財・人材活用

先端プロセス向けの中国への米国製造装置の輸出制限(日本の製造装置も足並み揃える)

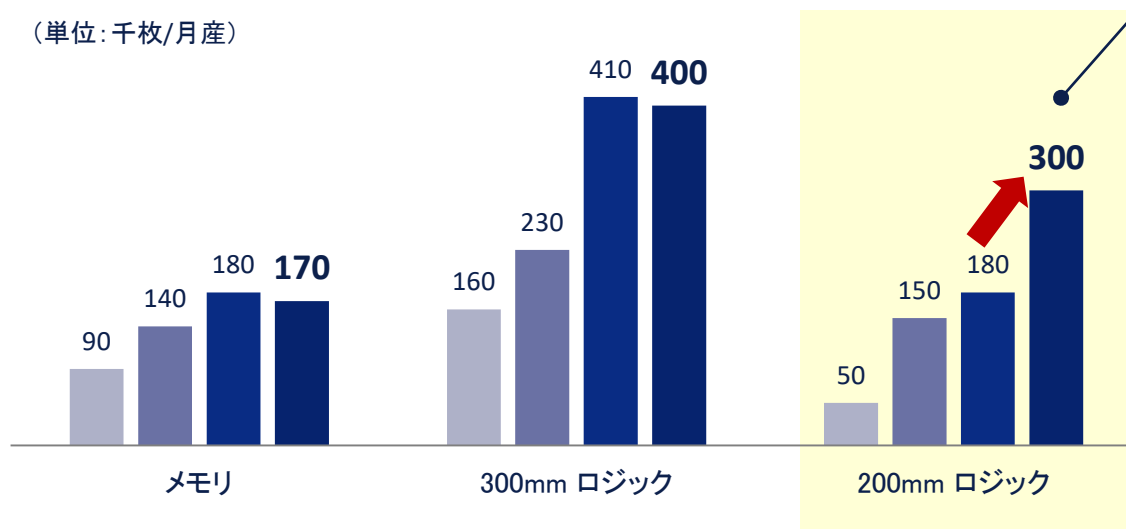


この為、**中国でのレガシー半導体投資**が積極化
⇒ **中国製の製造装置の国産化**が加速する見通し

中国半導体工場 月産能力追加分

■ 2019 ■ 2020 ■ 2021予 ■ 2022予

(単位:千枚/月産)

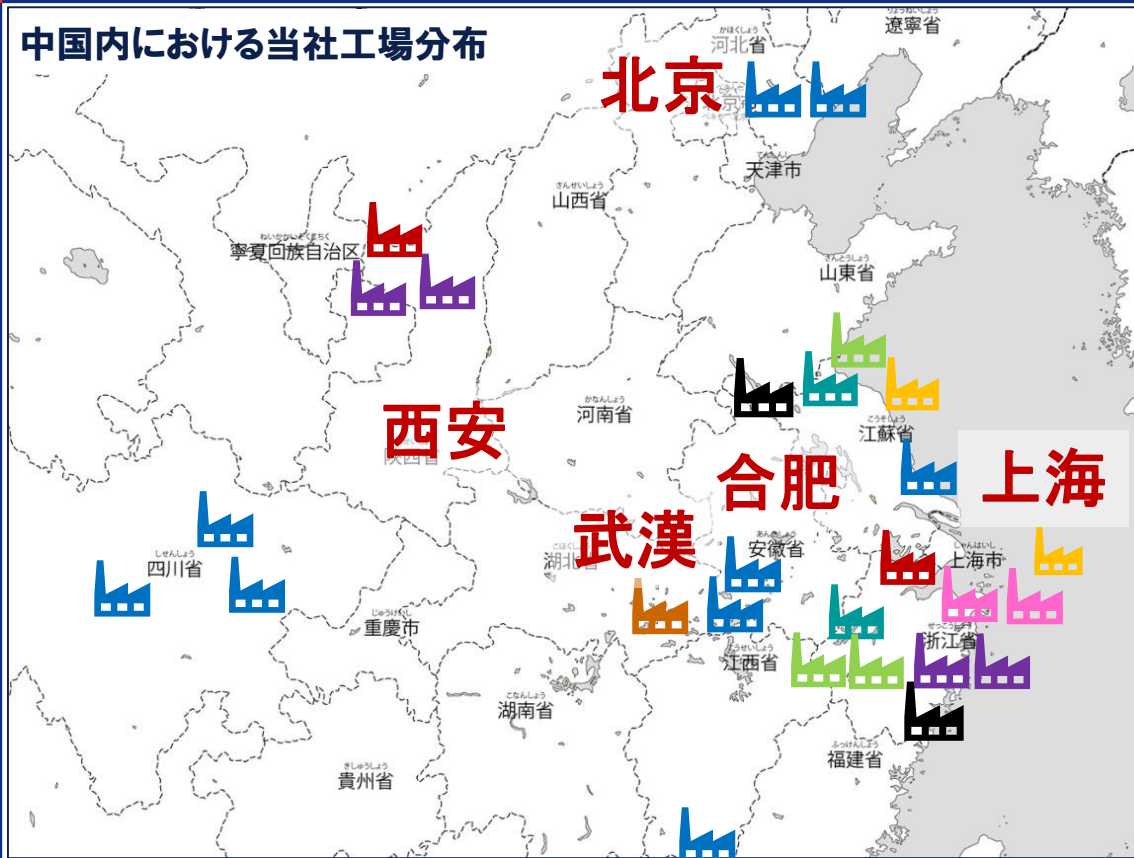


中国ファンドリー大手の
設備投資は、200mmも旺盛

当社においては
・マテリアル製品
・部品洗浄
・金属受託加工
などの売上増が期待される

フェロテックグループの中国での生産拠点マップ

中国内における当社工場分布



中国半導体企業主要拠点の近くに生産拠点を配置し、顧客の満足度向上に取り組むことで、国産化を前提とした市場成長に貢献し、同時に事業拡大を実現する

- | | |
|----------|------------------------|
| 半導体ウェーハ | サーモジュール |
| 石英 | 真空シール |
| セラミックス | 再生ウェーハ |
| 部品洗浄 | 赤字は中国半導体企業的主要拠点 |
| パワー半導体基板 | ①北京 ②上海 |
| シリコンパーツ | ③武漢 ④合肥 |
| | ⑤西安 |

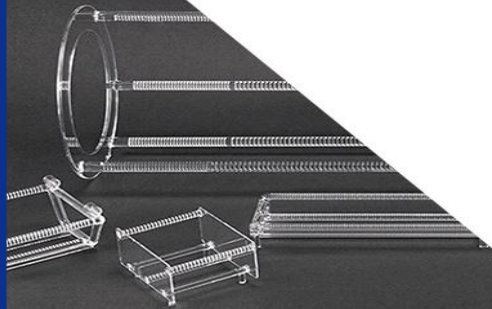
※21年以降、安徽省銅陵で、更にSiC(炭化ケイ素)ウェーハの生産開始



Ferrotec
Ferrotec Holdings Corporation



新中期経営計画の方針、基本戦略について



KPIサマリー(最終年度24/3期目標値)

売上高

1,500億円

営業利益

250億円

(同利益率16.7%)

当期純利益

150億円

(同利益率10.0%)

ROE

15%

ROIC

8%

自己資本比率

40%超

- 中期経営計画で策定した23/3期予想を1年前倒しで達成および超過の見通し

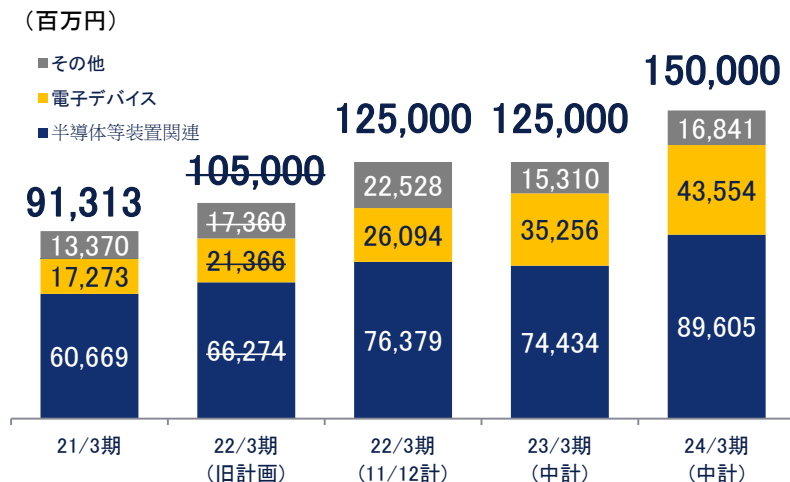
KPI項目 (金額:百万円)	20/3期	21/3期	22/3期 (期初計画)	22/3期 (11/12計画)	23/3期 (中計)	24/3期 (中計)
連結売上高	89,478	91,312	105,000	125,000	125,000	150,000
営業利益	6,012	9,640	15,000	22,500	19,000	25,000
営業利益率:%	7.4%	10.6%	14.3%	18.0%	15.2%	16.7%
当期純利益	1,784	8,280	7,800	23,500	11,000	15,000
ROE:%	3.6%	14.3%	-	(2Q時点)27.4%	-	15%
ROIC:%	1.4%	7.2%	-	(2Q時点)24.4%	-	8%
自己資本比率:%	25.5%	37.9%	-	(2Q時点)43.1%	-	40%超
設備投資額	33,920	14,297	40,000	32,000	29,000	26,000
年間配当(円)	24円	30円 (記念配4円含む)	28円	46円	利益成長により株主還元を増加	

※ ROIC = 親会社帰属純利益 / (有利子負債 + 純資産)
純資産は新株予約権、非支配株主持分除く

- 半導体市場の当面の伸長を背景に、最終年度の業績は1,500億円を目標とする
- 最適な事業ポートフォリオの確立に取り組み、最終年度営業利益率は16.7%を目標とする

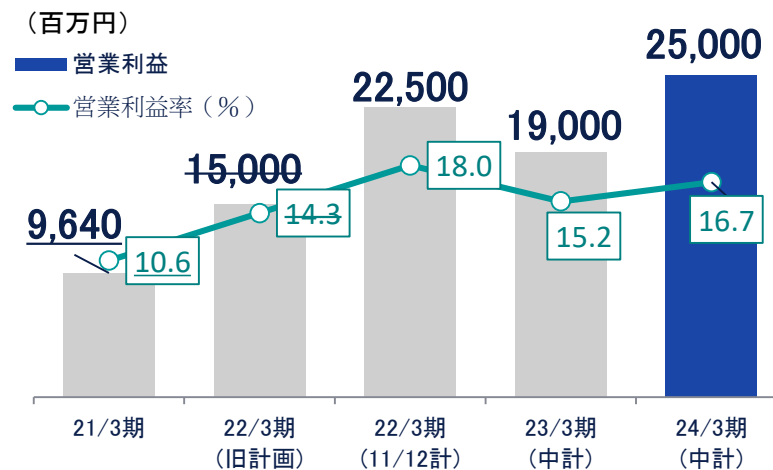
売上高 (24/3期)

1,500億円



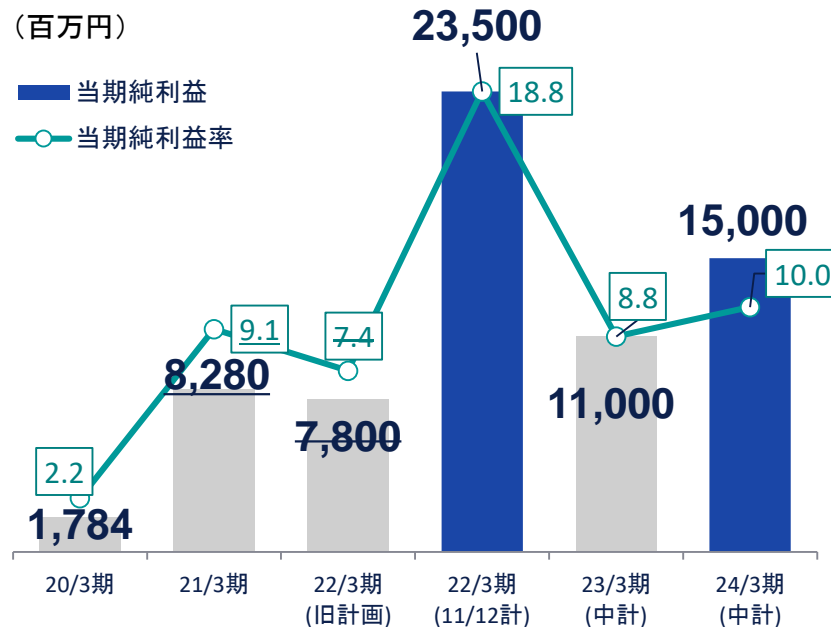
営業利益 (24/3期)

250億円 (同利益率: 16.7%)



- 株主還元(配当)の原資となる当期純利益*をKPIに設定
- 収益力を強化し、業績向上により株主還元を増加させていく方針

当期純利益*
最終年度目標(24/3期)
150億円
(同利益率10.0%)



事業成長

事業成長・利益成長を徹底的に追及、成長投資を継続

- 成長期待の高い半導体分野、電子デバイス分野での増産投資を進め、当社ポジションを引上げ
- 将来の成長に向け、EV(電気自動車)関連等への投資も推進

財務強化

財務強化を更に推進、投資機会と財務状況の適切なバランスを確保

- 当期純利益をKPI化、投資リターン・ROIC管理を強化、外部資本活用を適切に検討

品質強化

「品質は命」と考え、品質管理の強化を進める

- 品質管理、自動化・デジタル化による生産体制強化を推進

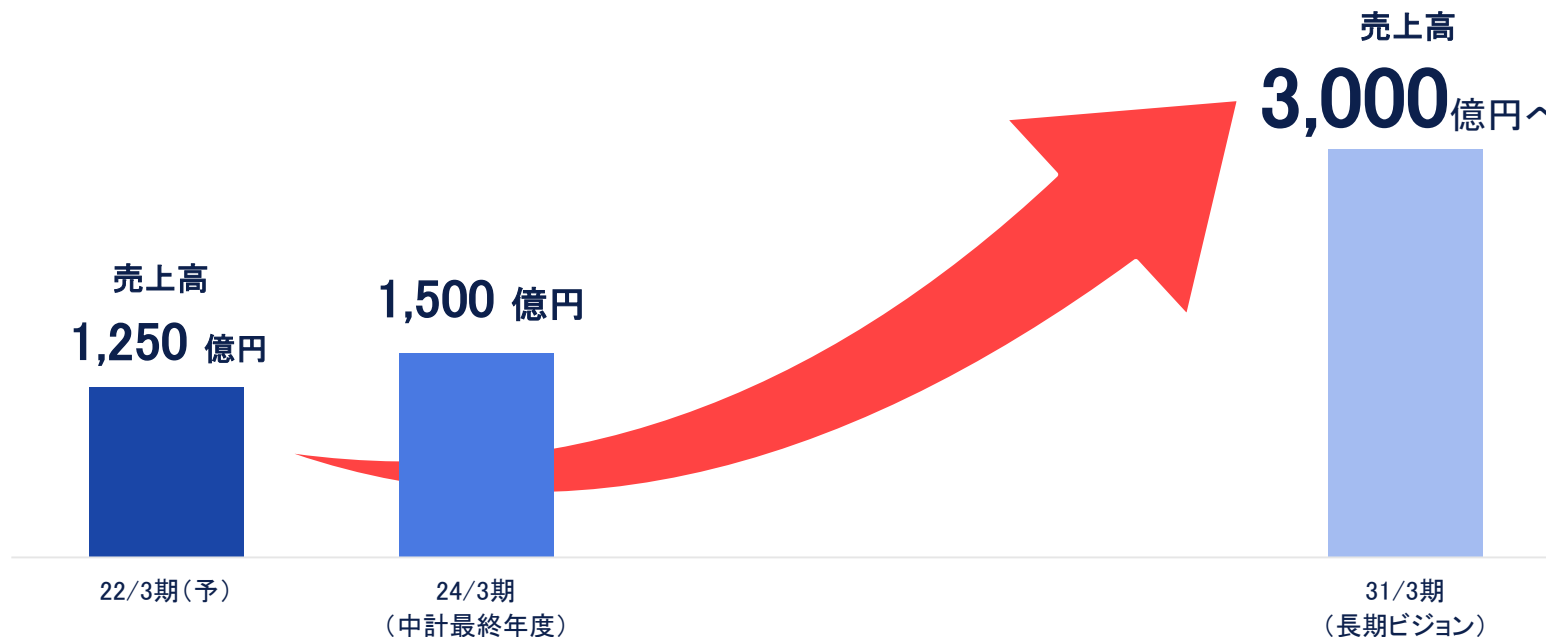
人材強化

人材の強化、組織の構造改革を推進

- 企業規模が拡大するなか、更に持続的な成長を実現するため、人材の採用・育成、組織態勢の改革、企業文化の醸成を推進

ビリオンダラーカンパニー*のその先へ

2030年度(31/3期)に売上高**3,000**億円 当期純利益**300**億円の達成を目指す！



- 本資料に掲載されている将来見通しの記述は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因の仮定を前提としております。
- 実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる可能性があります。業績に影響を与える要素には、国際情勢、経済情勢、製品の需給動向、原材料価額及び市況、為替レートなどが含まれますが、これに限定されるものではありません。
- 本資料中の定量目標などは、あくまで中長期的な戦略、ビジョン等を示すものであり業績予想ではありません。当社はこれらについて情報を更新する義務を負いません。
- 正式な業績予想は、東京証券取引所規則に基づく決算短信での開示をご参照ください。

<本件照会先>

IR室 03-3281-8186